

2017年3月期 第2四半期（2016年4月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2016年10月28日

内容：

- 第2四半期連結決算の概要 代表取締役専務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想修正 代表取締役社長、CEO 河合 利樹

第2四半期 連結決算の概要

2016年10月28日

堀 哲朗
代表取締役専務執行役員



2017年3月期 上期のハイライト

- 売上高 3,527億円（前上期比 +3.5%）
 - ファウンドリの旺盛な先端ノード投資とDRAMメーカーの微細化投資により、台湾向け売上が2半期連続で800億円超と高水準
 - ファウンドリと3D NAND向け投資により、中国向け売上が半期ベースで過去最高の540億円
- 1株当たり当期純利益：255.83円（前上期比 +7.4%）
- 上・下期ともに想定以上の売上、通期の業績・配当予想を上方修正

損益状況

(億円)

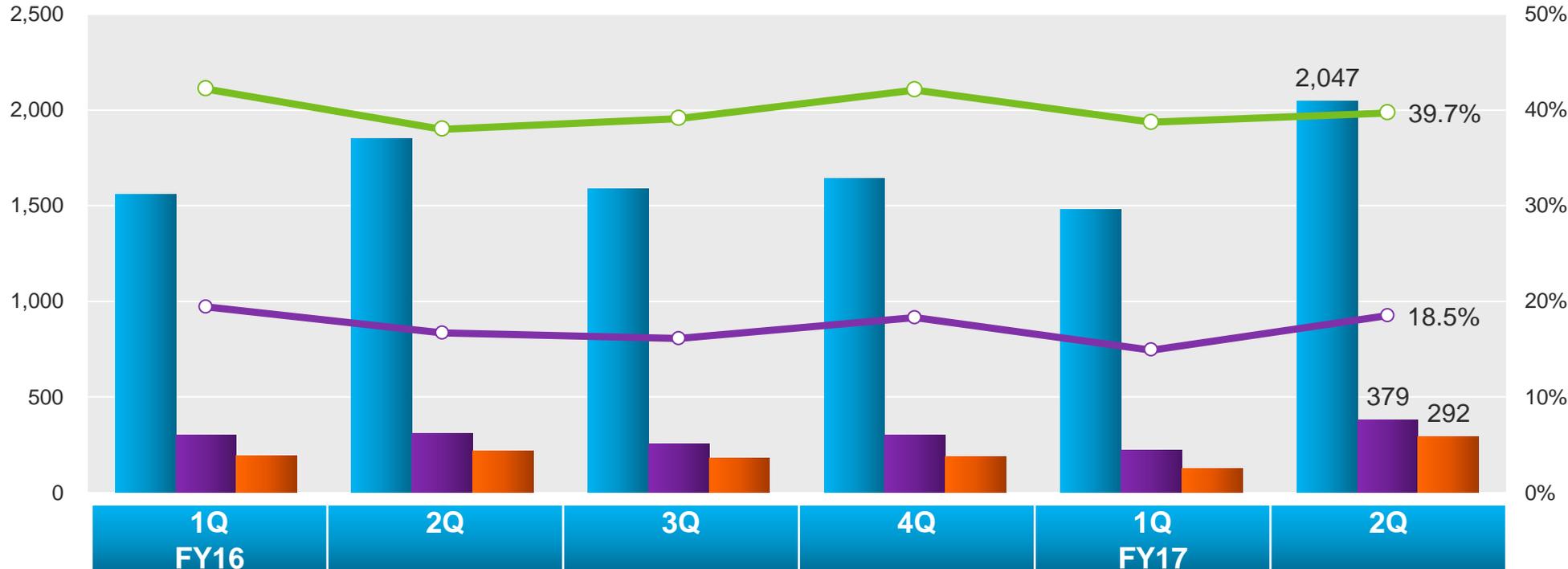
	2016年3月期		2017年3月期	対前年上期 増減	(ご参考) 5/12発表の 2017年3月期 上期予想
	上期	下期	上期		
売上高	3,409	3,229	3,527	+3.5%	3,300
売上総利益 下段：売上総利益率	1,360 39.9%	1,311 40.6%	1,386 39.3%	+2.0% -0.6pts	
販管費	747	756	786	+5.2%	
営業利益 下段：営業利益率	612 18.0%	555 17.2%	600 17.0%	-2.0% -1.0pts	490 14.8%
税前利益	575	489	544	-5.4%	390
親会社株主に帰属する 当期純利益	413	365	419	+1.4%	290
研究開発費	375	387	398	+5.9%	
設備投資額	48	85	94	+94.7%	
減価償却実施額	93	98	81	-12.6%	

当初想定に比べ、ファウンドリ向けの売上が大きく伸長

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況

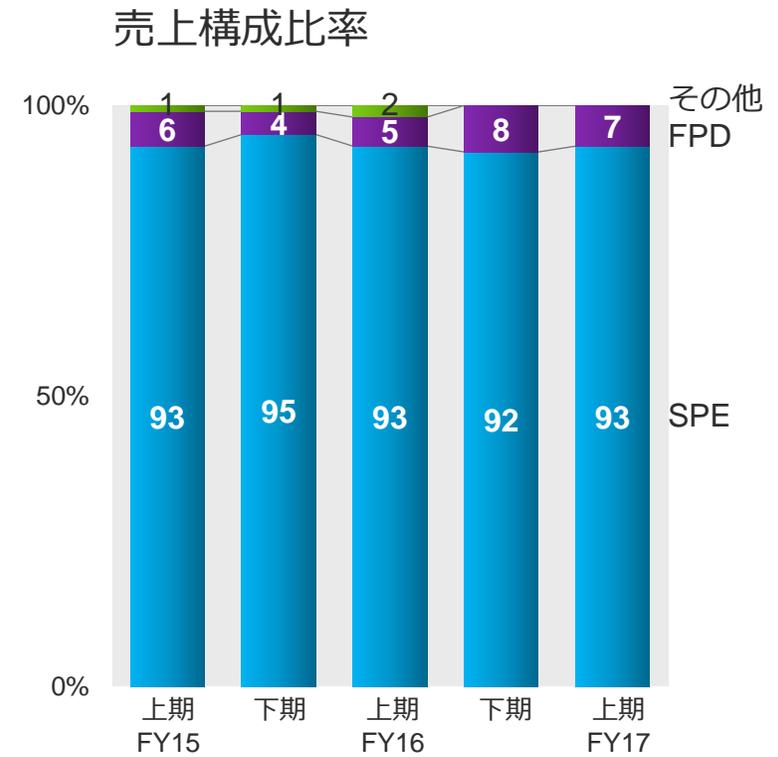
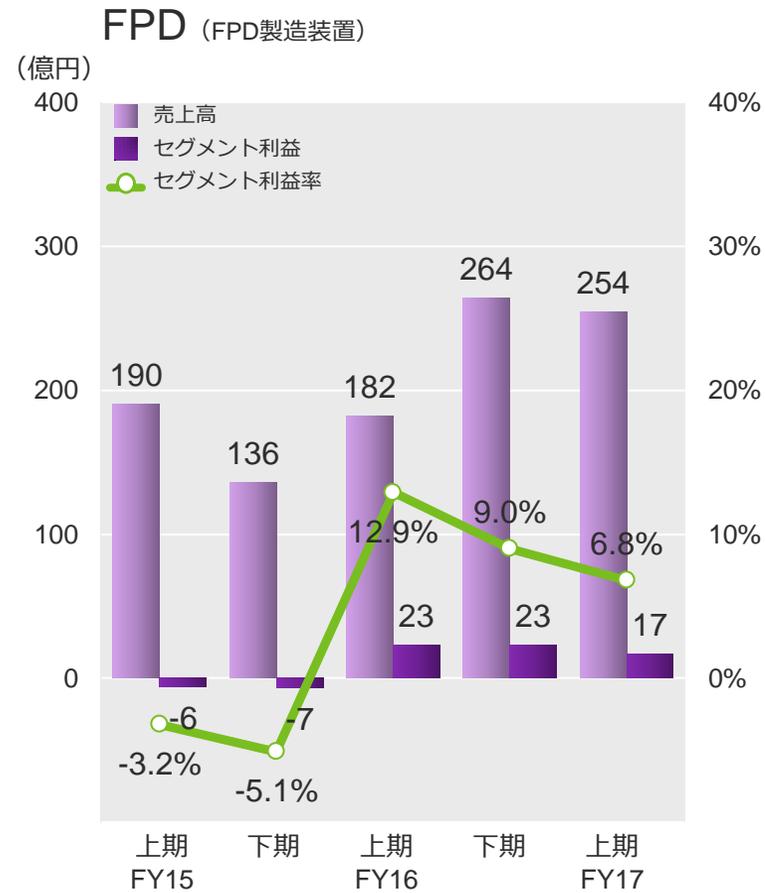
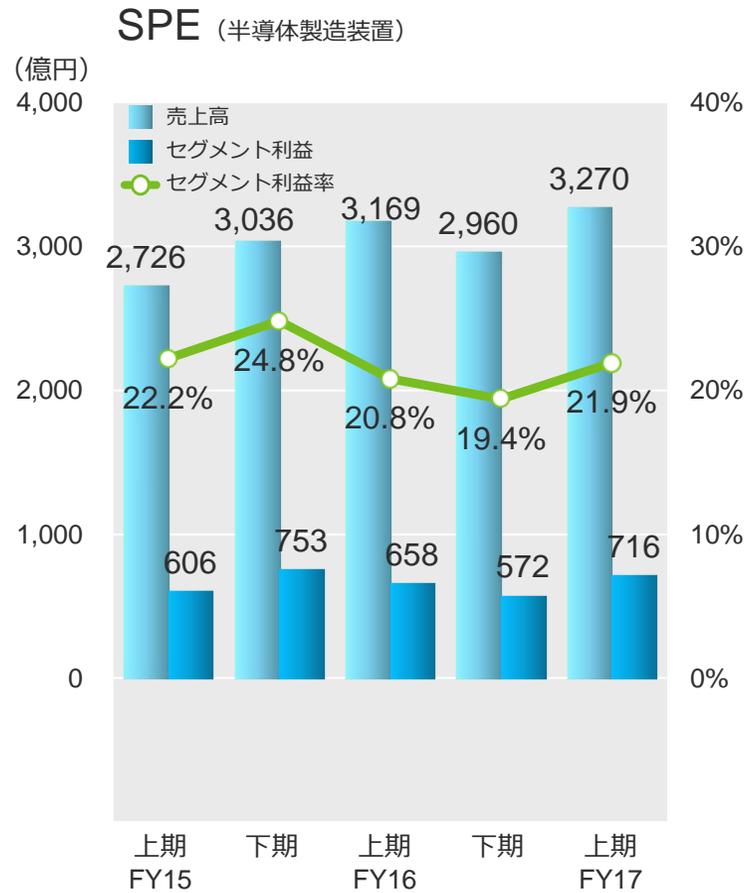
(億円)
2,500



売上高	1,557	1,851	1,587	1,642	1,479	2,047
営業利益	302	309	255	300	220	379
親会社株主に帰属する 当期純利益	194	218	178	186	126	292
売上総利益率	42.2%	38.0%	39.1%	42.1%	38.7%	39.7%
営業利益率	19.4%	16.7%	16.1%	18.3%	14.9%	18.5%

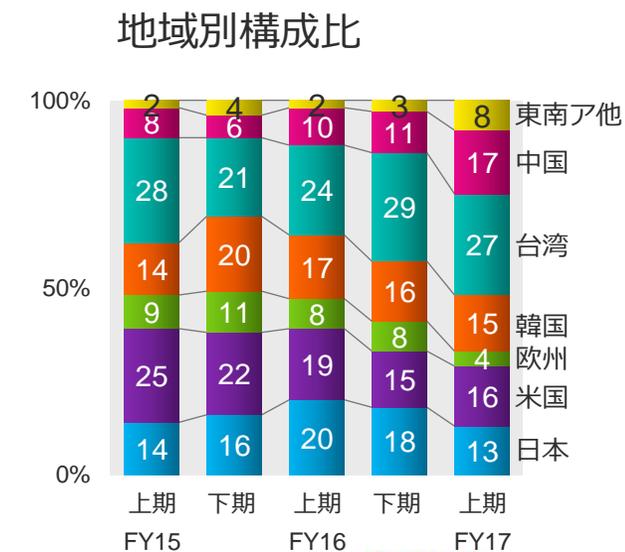
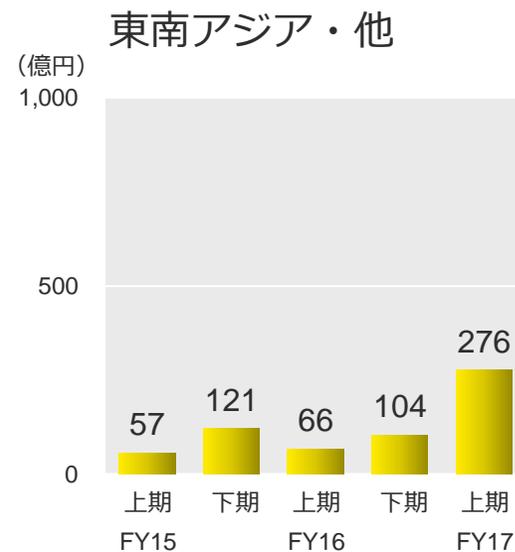
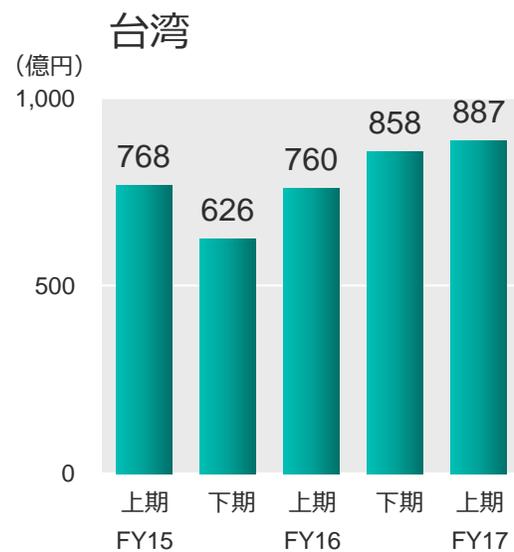
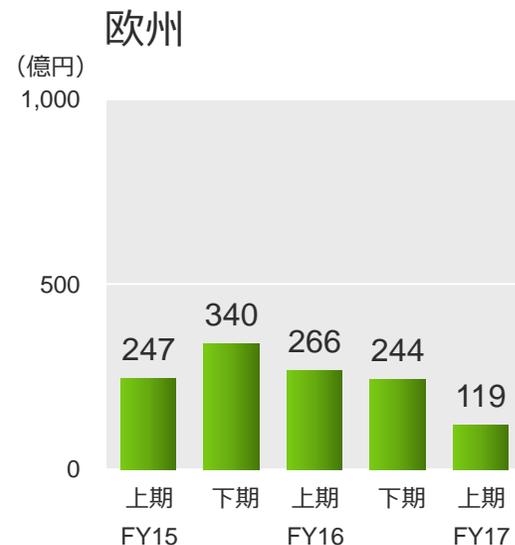
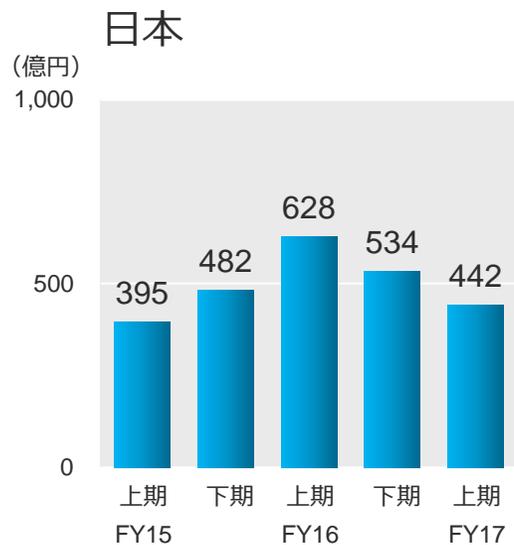
前四半期比で開発費・販管費増加も、営業利益率は18.5%に向上

セグメント情報



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、FY16/1Qより報告セグメントから除外しました。
4. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。PV製造装置事業はその他に含めています。

SPE部門地域別売上高



貸借対照表

資産

(億円)



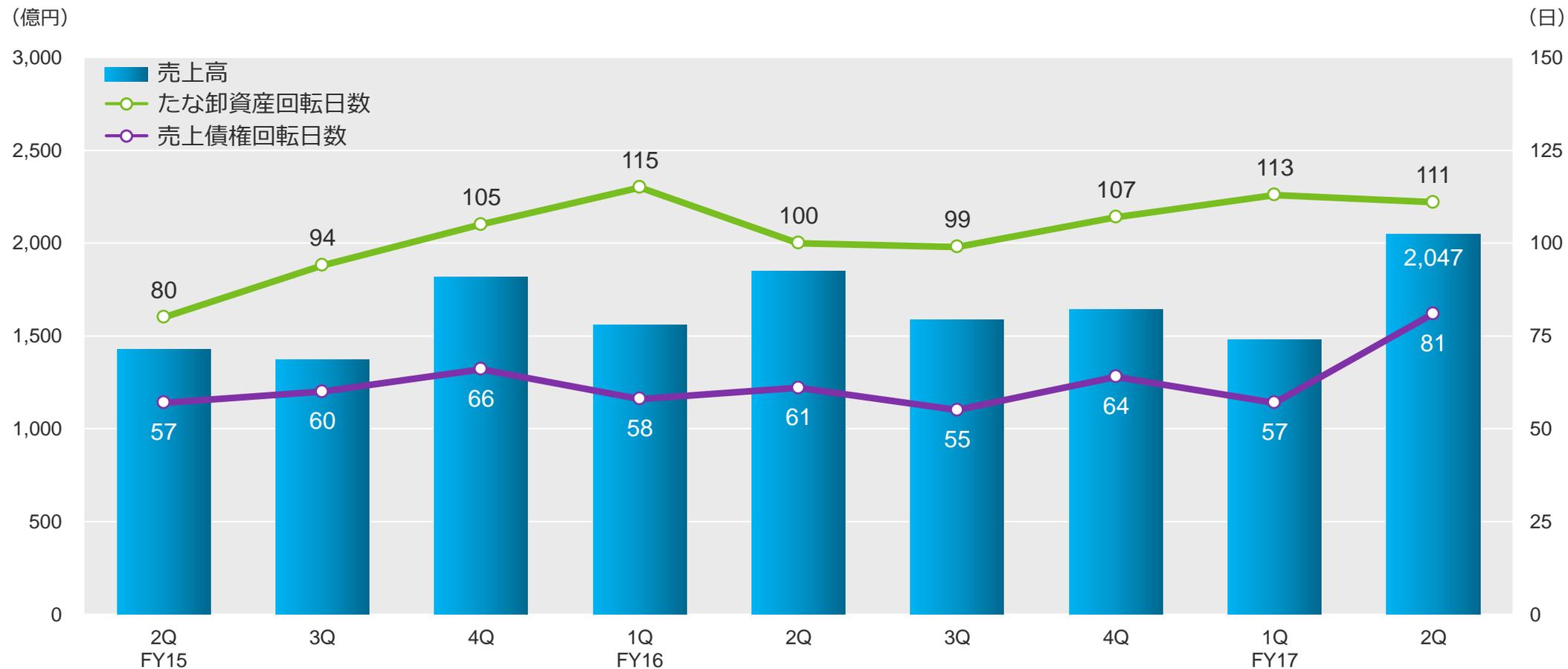
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

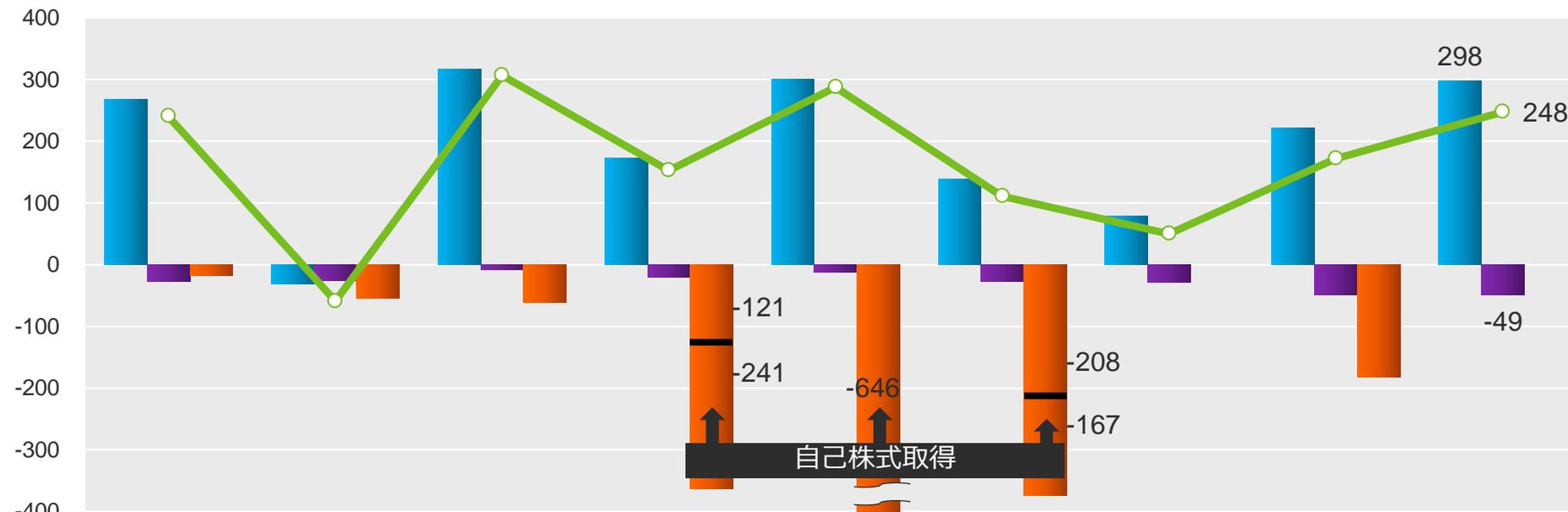
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	2Q FY15	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17	2Q
■ 営業キャッシュ・フロー	268	-32	317	173	301	138	79	221	298
■ 投資キャッシュ・フロー*	-27	-26	-9	-20	-12	-27	-29	-49	-49
■ 財務キャッシュ・フロー	-18	-54	-62	-363	-646	-375	0	-183	0
○ フリーキャッシュ・フロー**	241	-59	307	153	288	111	50	172	248
手元資金残高***	2,991	2,853	3,176	2,989	2,607	2,338	2,366	2,309	2,556

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

【訂正】 四半期 受注高・受注残高の一部訂正

当社が開示した受注高・受注残高の一部に誤りがあり、訂正をいたしました。
詳細につきましては、決算短信および説明会補足資料をご覧ください。
なお、訂正項目は受注関連のみであり、監査対象である財務諸表への影響はございません

- 原因：
米国子会社において、特定の取引事象に関して、受注高を二重に集計するプログラム上の不具合が生じていたため、受注高および受注残高に誤りがありました
- 訂正範囲： 2011年3月末以降の受注残高、2011年4-6月期以降の受注高を訂正いたしました
影響度： 連結受注高に対して0.4%過少～1.9%過剰の範囲で差額が生じておりました
2016年6月末における受注残高の2.8%（104億円）が過剰に報告されておりました
- 再発防止：
他地域においては問題が無いことを確認しておりますが、今後は監査対象外である項目においても、いっそうの業務プロセスの検証、数値確認を精緻に行い、再発防止に努めてまいります

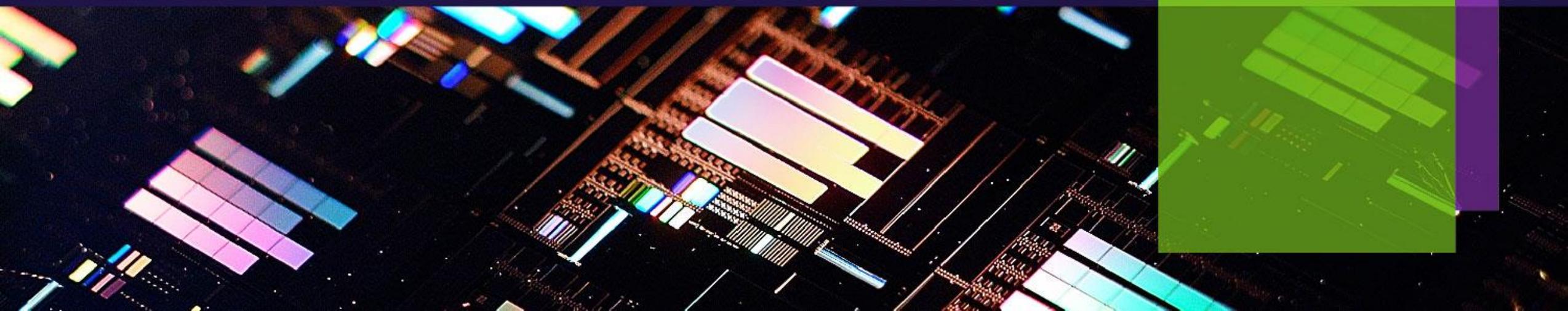


事業環境および業績予想修正

2016年10月28日

河合 利樹

代表取締役社長、CEO



2017年3月期 上期のハイライト

■ 半導体製造装置

- エッチング装置 : 市場成長を上回る前年比10%以上の売上拡大
- 成膜装置 : ロジックにおいてNT333™のPOR獲得
- 洗浄装置 : 3D NANDのバッチ工程でシェア拡大。ベベル工程で一層の採用が進む
- コータ/デベロッパ : 液浸・EUVにおいて高シェア維持。顧客へ新技術の性能を実証
- テストシステム : 3D NAND向けにCellcia™の顧客展開が進む。FOWLP*向けで売上拡大
- FS事業** : 新しい取り組みである再製作装置、高付加価値サービスの展開

■ FPD製造装置

- 第10.5世代基板サイズ向けエッチング装置、コータ/デベロッパの受注獲得
- 中小型パネル向け新製品PICP™***エッチング装置が多数の顧客で採用される

中期計画達成に向けて着実に前進

*FOWLP : 半導体パッケージの新技術 ** FS: フィールドソリューション ***PICP : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

事業環境（2016年10月時点での見方）

▶ 半導体設備投資

CY2016の半導体前工程(WFE*)の設備投資額は、当初想定よりもファウンドリの投資が拡大し、\$33Bを見込む。CY2017も、3D NANDおよび先端ノード向けロジック投資に牽引され、プラス成長を予想

▶ FPD設備投資

CY2016のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資を中心に、前年比30%の増加を見込む。CY2017も、中小型向けの投資継続とG10.5の立ち上がりにより、一層の投資拡大を予想

装置市場は、次世代技術への活発な投資により拡大が続く

* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
WFEは、前工程で使用される製造装置です。

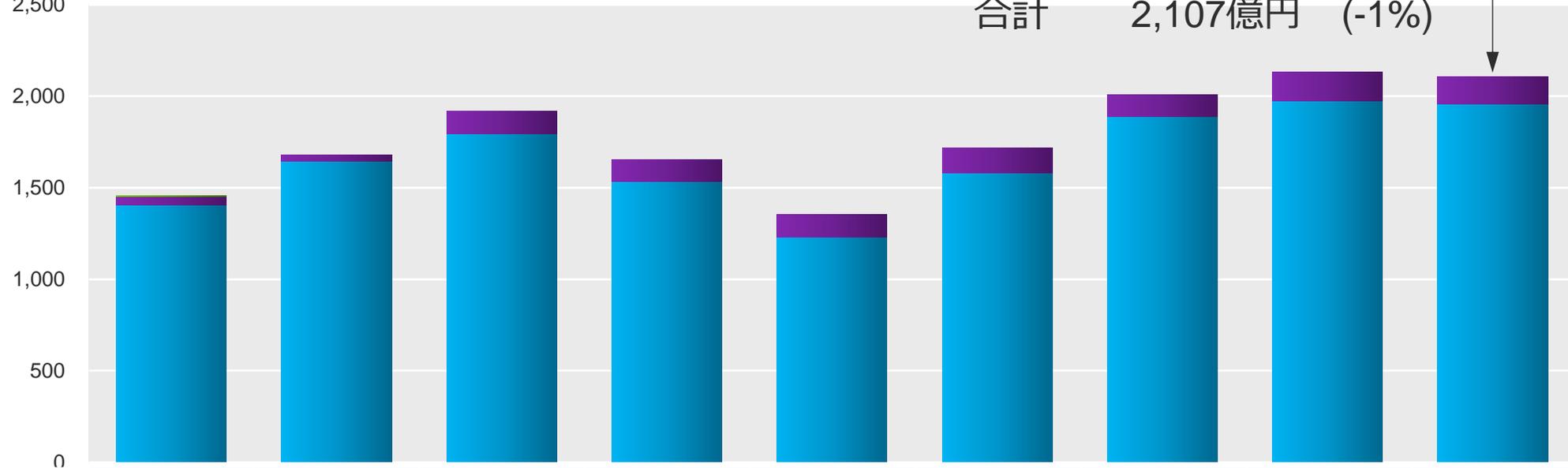
** TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

四半期 受注額・受注残高

2016/7-9月期

SPE	1,956億円	(-1%)
FPD	150億円	(-6%)
合計	2,107億円	(-1%)

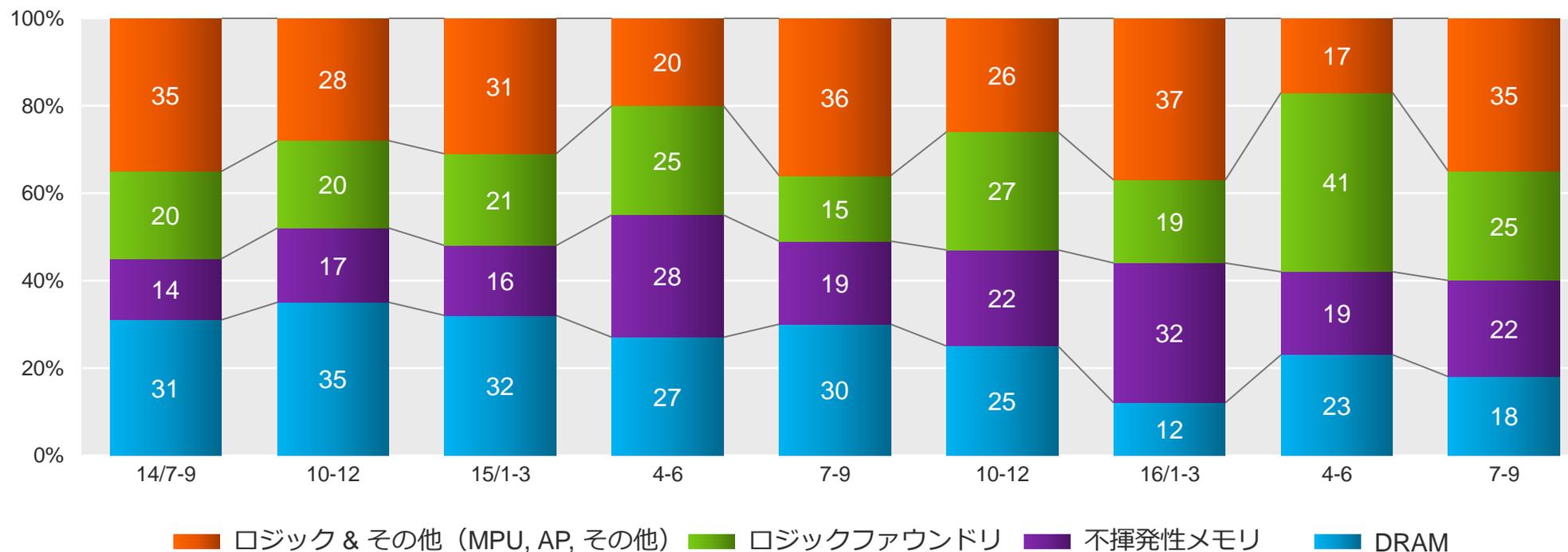
(億円)
2,500



	14/7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9
■ SPE受注額	1,405	1,643	1,792	1,534	1,228	1,579	1,886	1,974	1,956
■ FPD受注額	48	34	126	118	125	139	122	159	150
SPE受注残高	2,133	2,457	2,533	2,664	2,126	2,241	2,632	3,299	3,294
FPD受注残高	291	288	316	333	376	399	374	363	429

先端ロジックと3D NAND向け投資により高水準

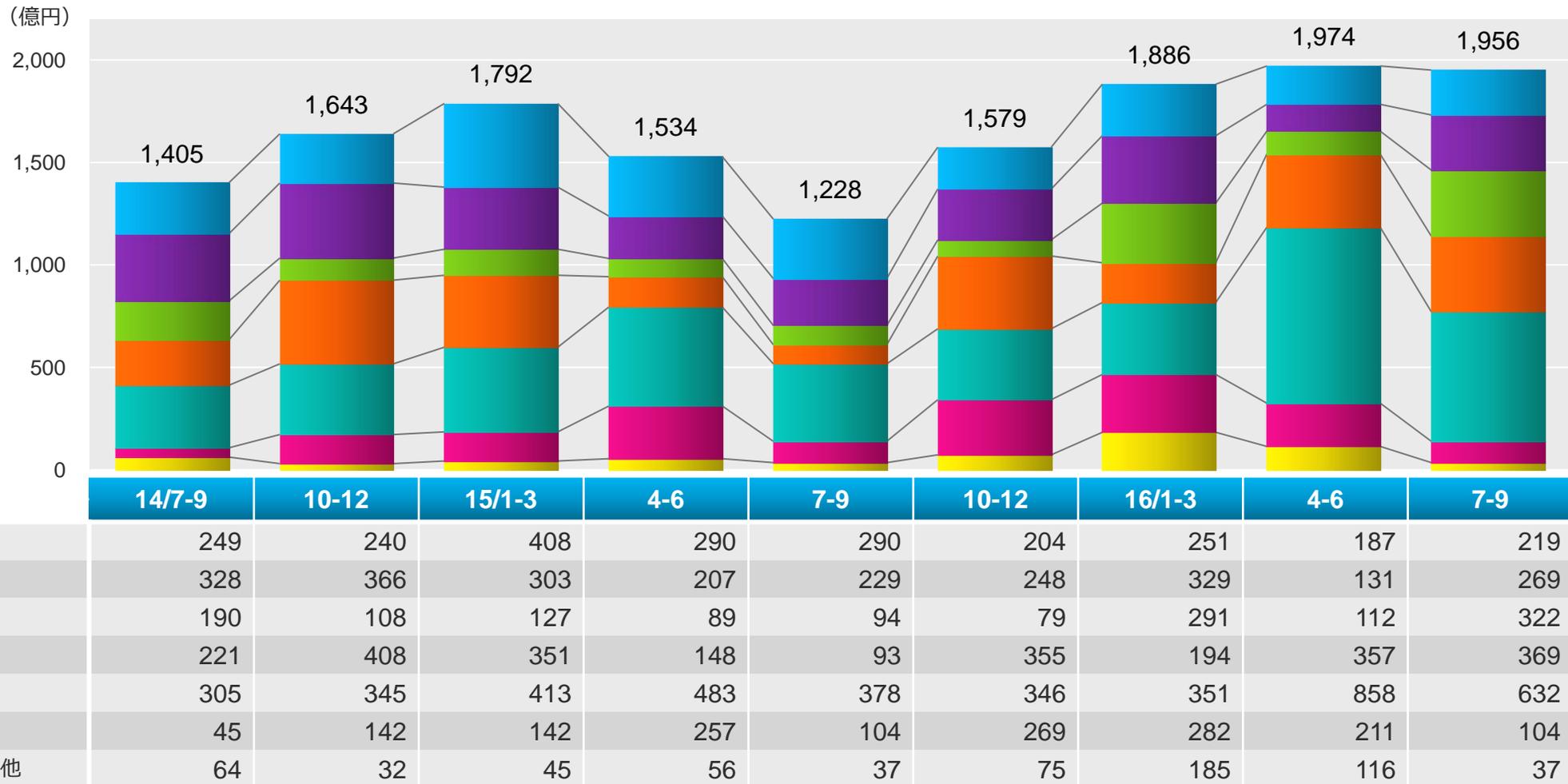
SPE受注アプリケーション別構成比



先端ノード向けロジック投資が伸長

グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額



米国および欧州のロジック向けが増加

2017年3月期 業績予想修正

2017年3月期 業績予想修正

(億円)

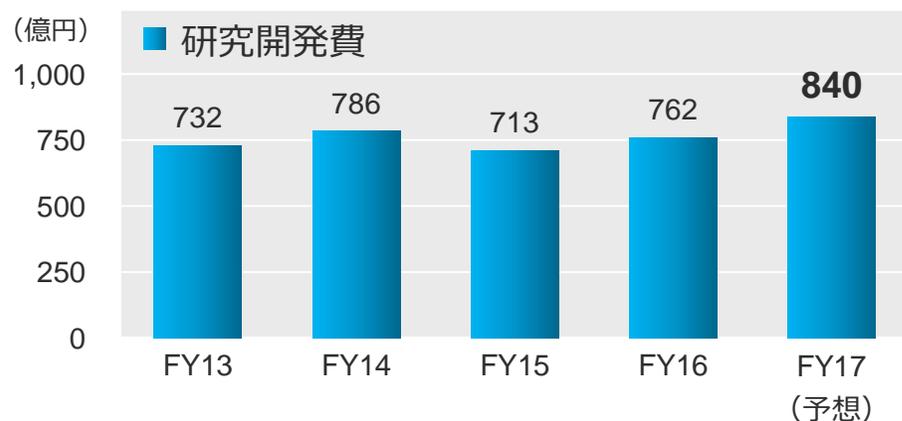
	FY2016 (実績)	FY2017 (予想)					
		上期	下期		通期		通期 対前年 増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	6,639	3,527	4,092	+252	7,620	+480	+14.8%
SPE	6,130	3,270	3,854	+244	7,125	+475	+16.2%
FPD	446	254	235	+5	490	-	+9.7%
販管費	1,504	786	853	+63	1,640	+80	+135
営業利益	1,167	600	800	+50	1,400	+160	+232
下段：営業利益率	17.6%	17.0%	19.6%	+0.1pts	18.4%	+1.0pts	+0.8pts
特別損益	-129	-79	0	+0	-80	+20	+49
税前利益	1,064	544	795	+45	1,340	+200	+275
親会社株主に帰属する 当期純利益	778	419	580	+20	1,000	+150	+221
1株当たり当期純利益 (円)	461.10	255.83	353.54	+12.15	609.57	+91.39	+148.47

技術革新の続く装置市場において持続的な利益成長を見込む

*修正額：2016/5/12に発表した業績予想からの修正額を示しています。 SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

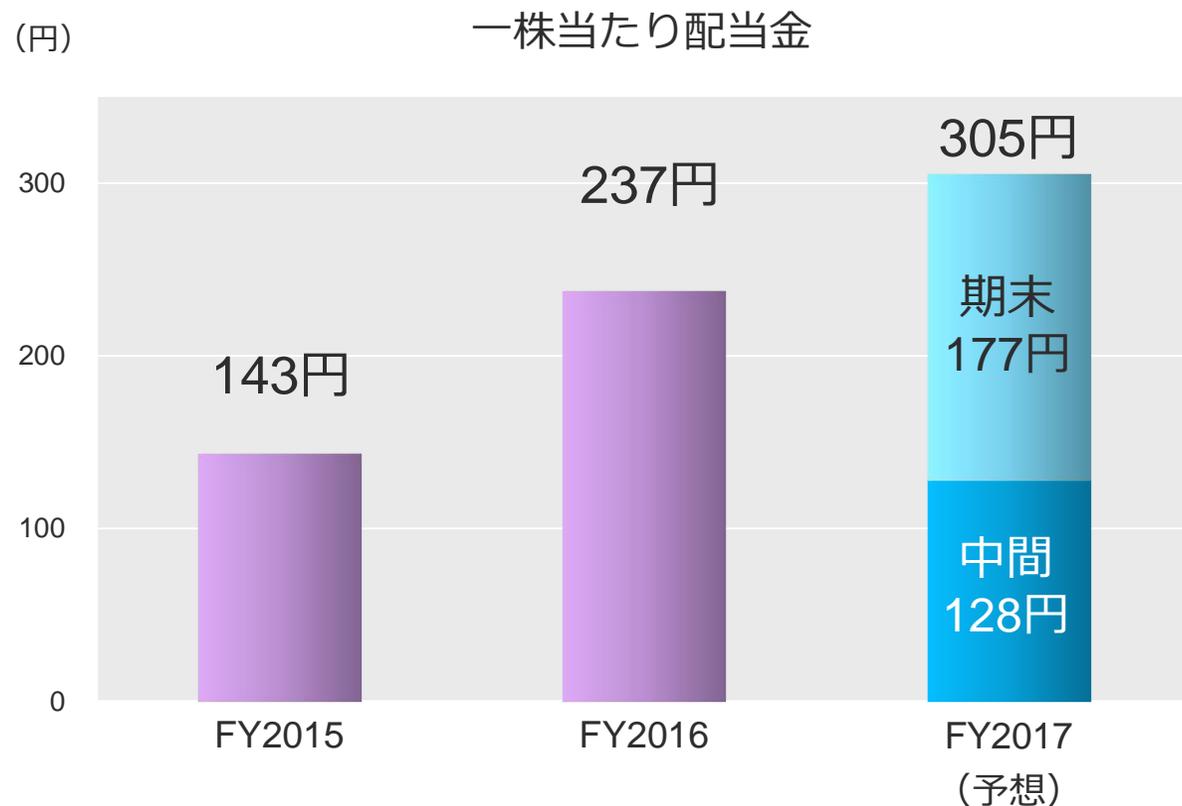
2017年3月期 業績予想について（5/12発表の業績予想との比較）

- 売上高 7,620億円（+480億円）
 - ファウンドリ顧客による先端ノード向けの投資拡大が、売上増加を牽引
- 開発費 800億円 ⇒ 840億円（+40億円）
 - 注力分野（エッチング、成膜等）への投資増加
- 設備投資 180億円 ⇒ 250億円（+70億円）
 - 開発・製造関連設備への投資



中期計画達成と更なる成長を視野に先行投資を加速

2017年3月期 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない

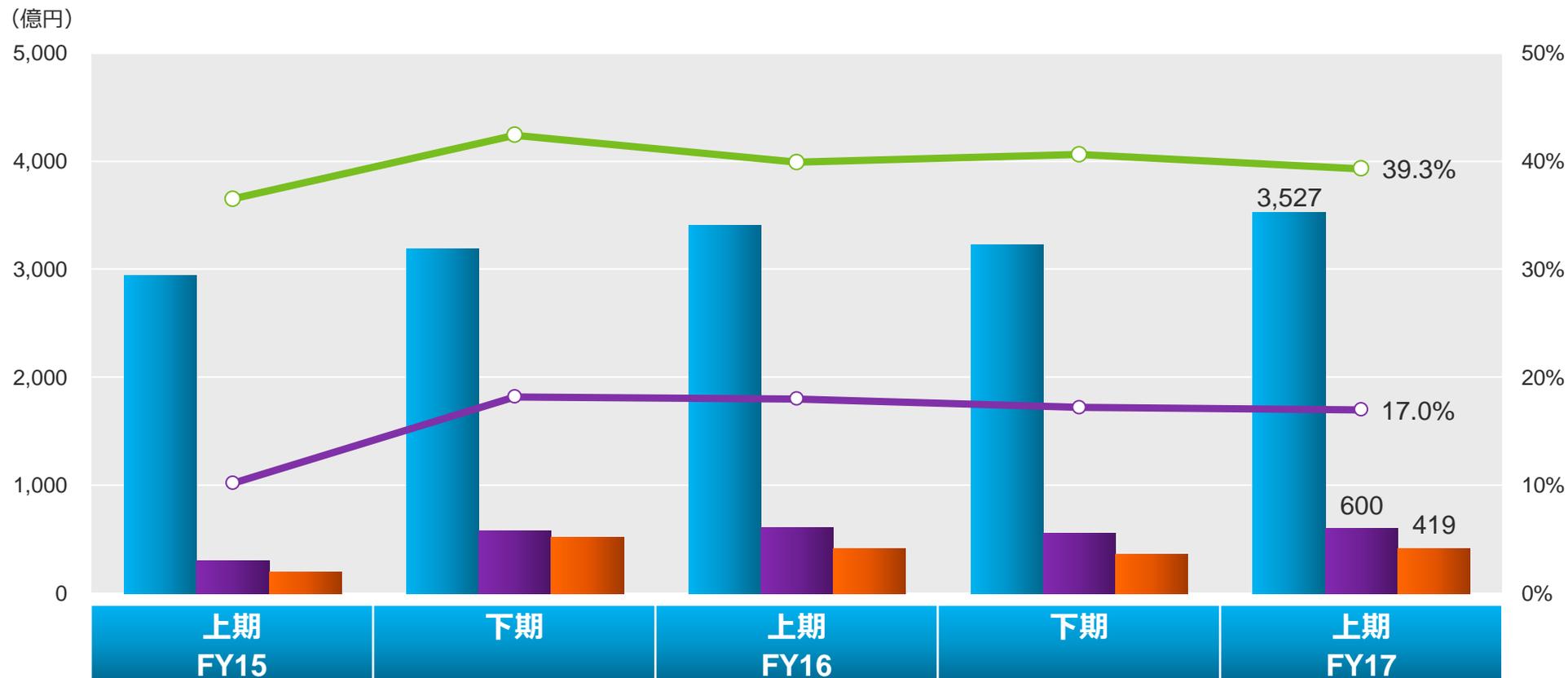
2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

一株当たり配当金は、3期連続で過去最高を更新予定

補足資料

損益状況



■ 売上高	2,942	3,188	3,409	3,229	3,527
■ 営業利益	301	579	612	555	600
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	200	518	413	365	419
○ 売上総利益率	36.5%	42.4%	39.9%	40.6%	39.3%
○ 営業利益率	10.2%	18.2%	18.0%	17.2%	17.0%

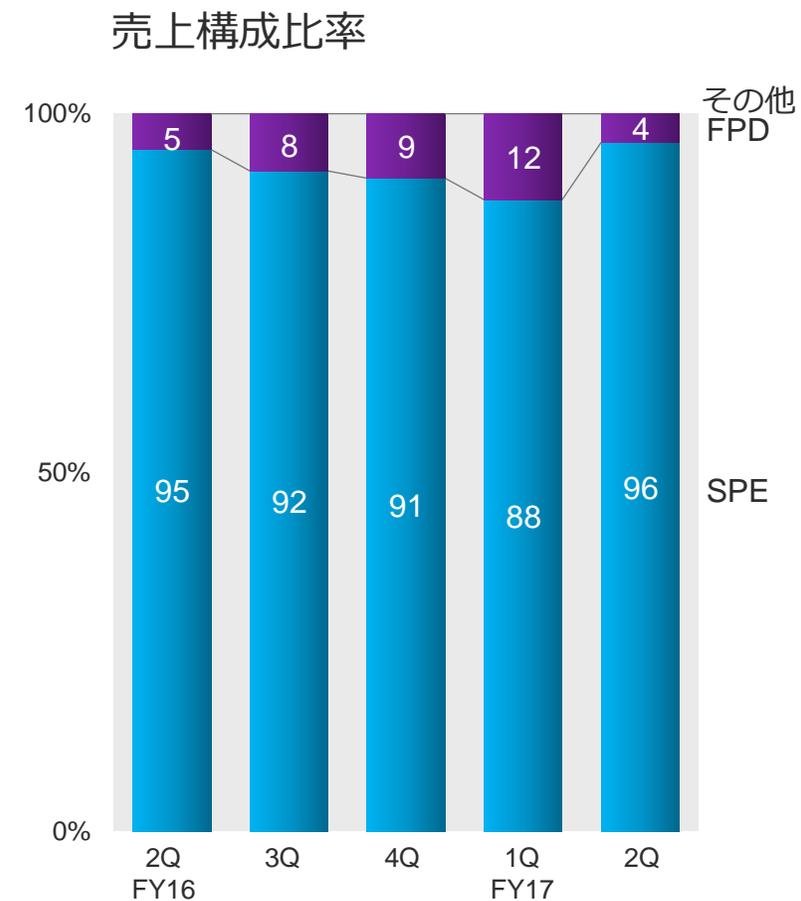
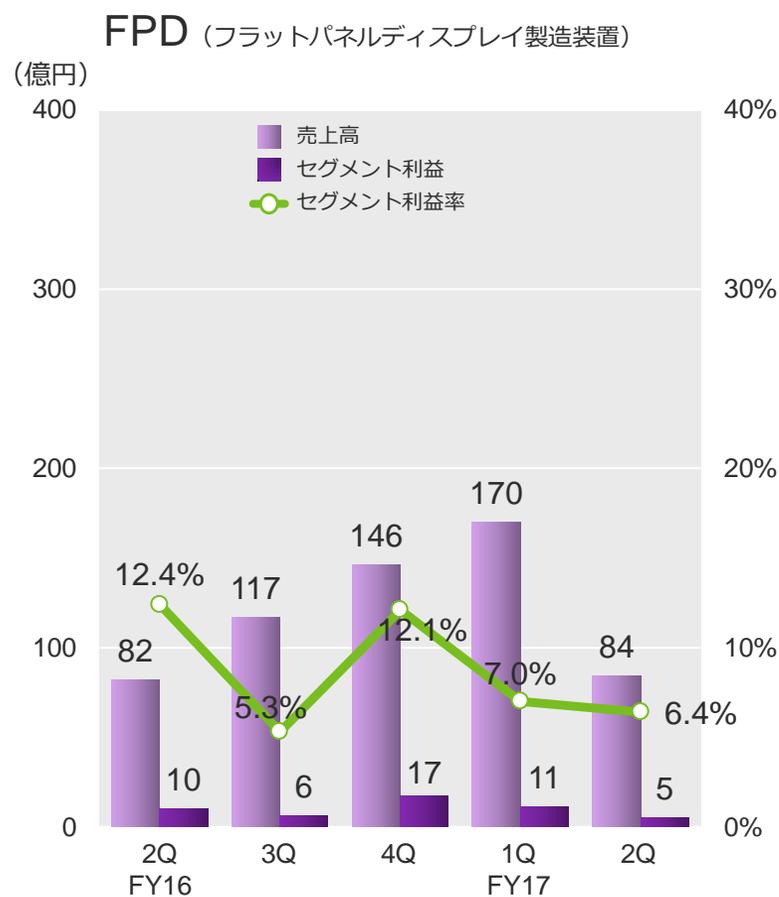
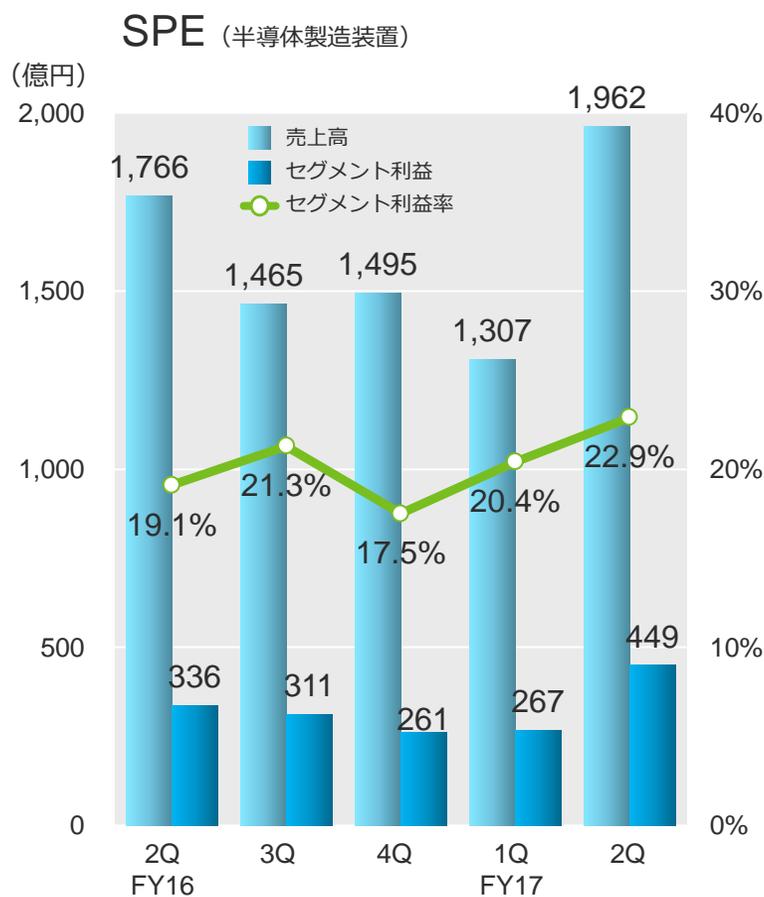
損益状況

(億円)

	2016年3月期			2017年3月期		対前年2Q 増減率
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
売上高	1,851	1,587	1,642	1,479	2,047	+10.6%
売上総利益 下段：売上総利益率	703 38.0%	620 39.1%	691 42.1%	573 38.7%	813 39.7%	+15.7% +1.7Pts
販管費	393	365	391	352	434	+10.5%
営業利益 下段：営業利益率	309 16.7%	255 16.1%	300 18.3%	220 14.9%	379 18.5%	+22.4% +1.8Pts
税前利益	284	251	238	161	382	+34.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	218	178	186	126	292	+33.7%
研究開発費	200	183	203	177	220	+10.2%
設備投資額	26	28	56	38	55	+105.9%
減価償却費	47	49	49	39	42	-11.5%

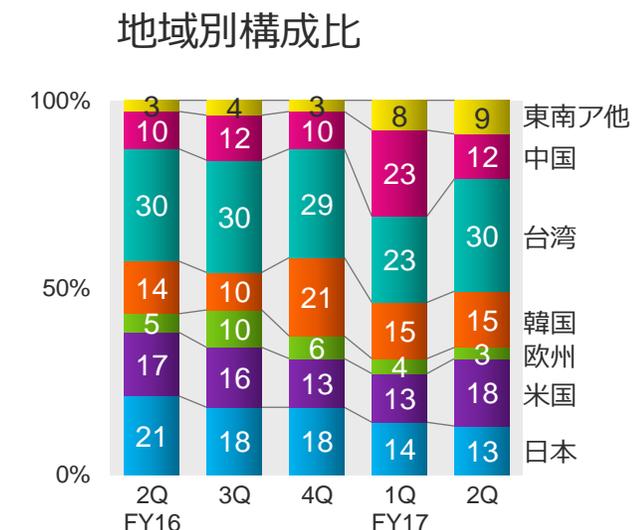
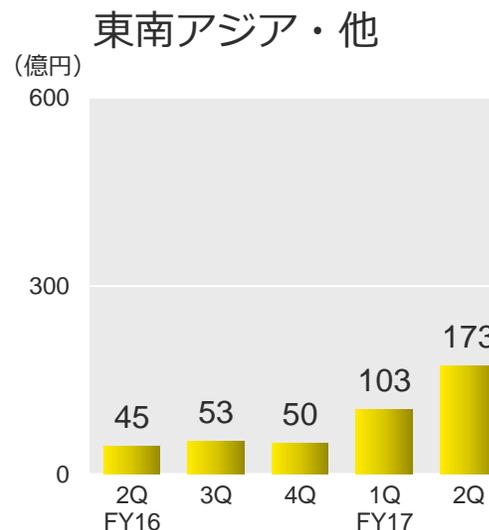
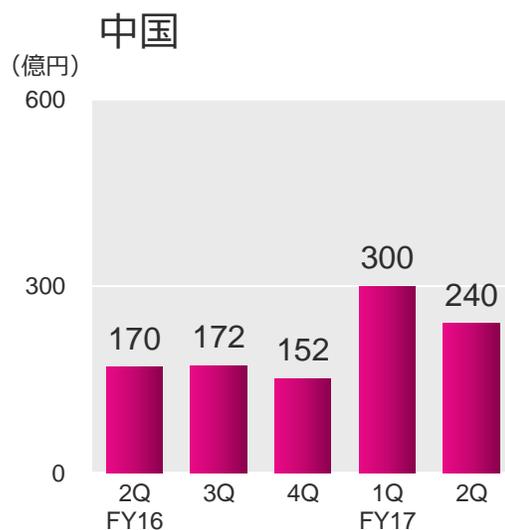
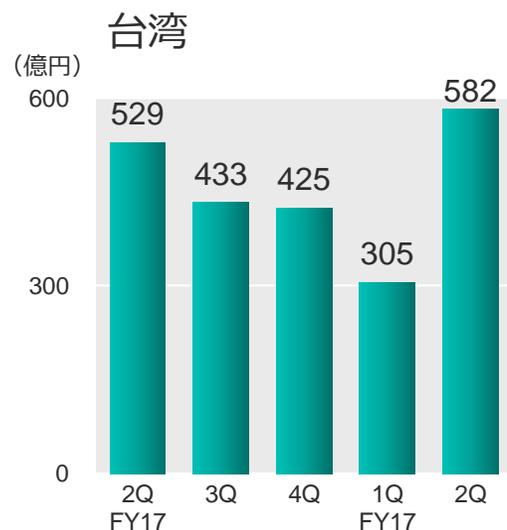
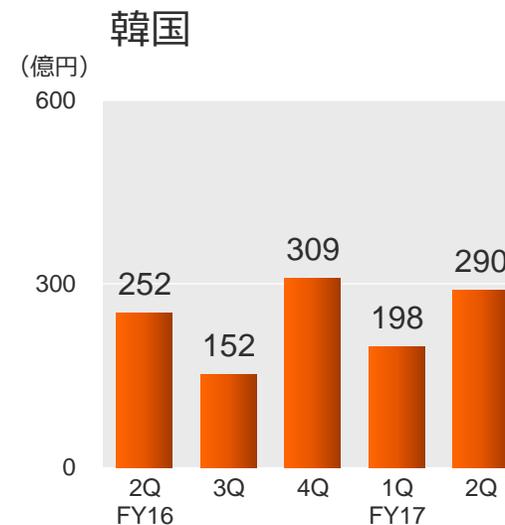
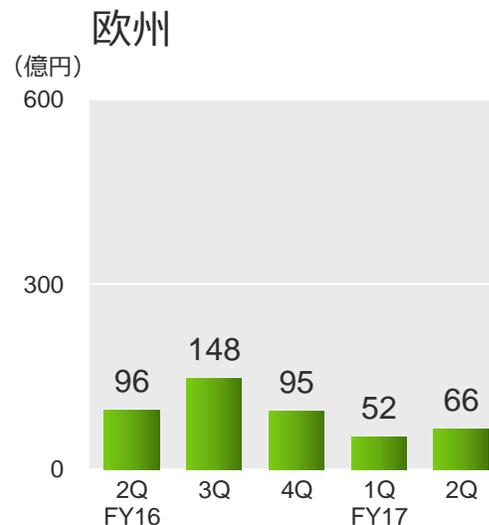
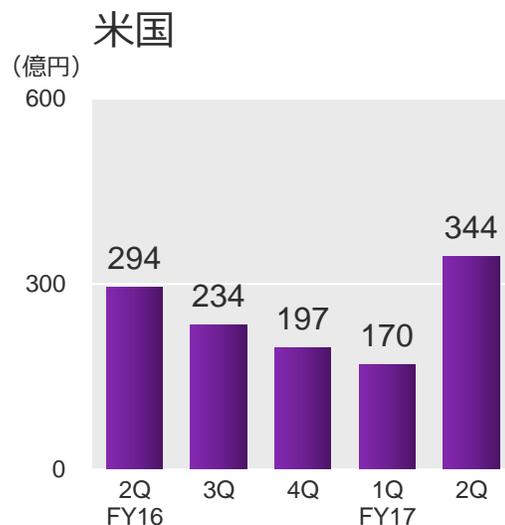
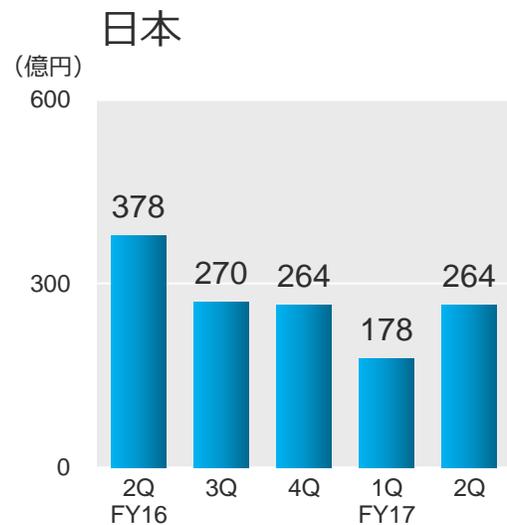
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

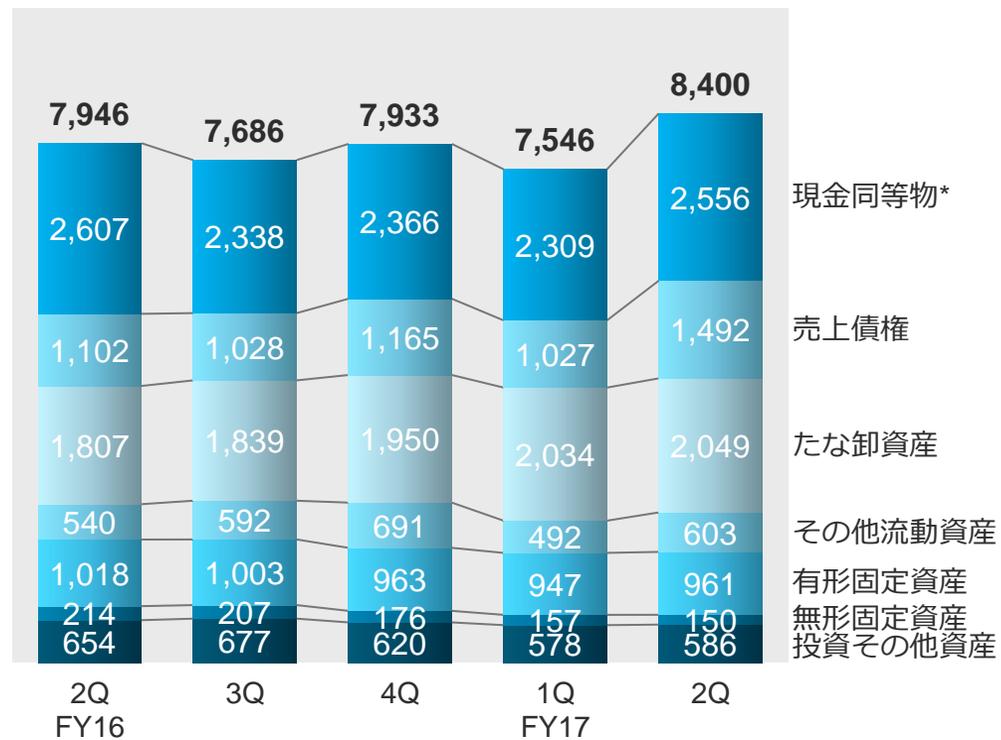
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

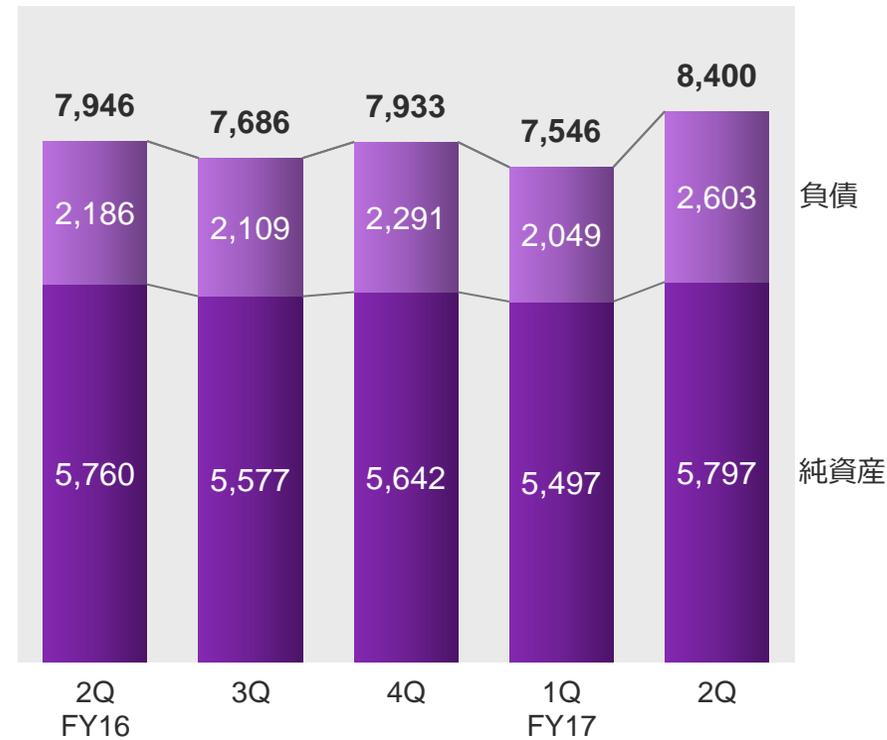
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

四半期 受注額・受注残高の訂正一覧

(億円)

(訂正前)	11/1-3	4-6	7-9	10-12	12/1-3	4-6	7-9	10-12	13/1-3	4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6
SPE受注額		1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224	1,593	1,878	1,974
連結受注額		1,442	949	1,705	1,311	1,015	958	1,136	1,396	1,373	1,836	1,754	1,997	1,522	1,474	1,722	1,889	1,703	1,352	1,737	2,000	2,135
SPE受注残高	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767	2,226	2,354	2,737	3,403
連結受注残高	3,088	2,999	2,216	2,630	2,166	1,858	1,491	1,800	1,808	2,150	2,476	2,846	2,651	2,488	2,533	2,886	2,957	3,103	2,603	2,753	3,111	3,767

(訂正後)	11/1-3	4-6	7-9	10-12	12/1-3	4-6	7-9	10-12	13/1-3	4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6
SPE受注額		1,124	733	1,450	1,063	760	668	912	1,083	977	1,514	1,433	1,542	1,366	1,405	1,643	1,792	1,534	1,228	1,579	1,886	1,974
連結受注額		1,439	948	1,706	1,311	1,015	957	1,135	1,397	1,373	1,837	1,752	1,995	1,516	1,454	1,693	1,884	1,671	1,355	1,724	2,008	2,135
SPE受注残高	2,285	2,202	1,660	2,194	1,879	1,569	1,178	1,417	1,408	1,637	1,953	2,364	2,088	2,093	2,133	2,457	2,533	2,664	2,126	2,241	2,632	3,299
連結受注残高	3,084	2,993	2,209	2,623	2,159	1,850	1,483	1,790	1,800	2,142	2,469	2,838	2,640	2,471	2,497	2,820	2,886	3,000	2,504	2,640	3,007	3,663

(訂正差額)	11/1-3	4-6	7-9	10-12	12/1-3	4-6	7-9	10-12	13/1-3	4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6
SPE受注額		-2	-1	0	-0	-0	-0	-1	1	0	1	-1	-1	-6	-19	-29	-4	-31	3	-13	8	0
連結受注額		-2	-1	0	-0	-0	-0	-1	1	0	1	-1	-1	-6	-19	-29	-4	-31	3	-13	8	0
SPE受注残高	-3	-5	-7	-6	-7	-7	-8	-9	-8	-8	-6	-8	-10	-17	-36	-66	-70	-102	-99	-112	-104	-103
連結受注残高	-3	-5	-7	-6	-7	-7	-8	-9	-8	-8	-6	-8	-10	-17	-36	-66	-70	-102	-99	-112	-104	-103

地域別受注額の訂正一覧

訂正箇所は朱文字で表示

(億円)

(訂正前)	SPE+FPD+PVE受注額								SPE受注額												
	11/4-6	7-9	10-12	12/1-3	4-6	7-9	10-12	13/1-3	4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6
国内	250	163	149	117	100	163	115	187	175	201	184	198	204	249	240	408	290	290	204	251	187
米国	311	248	297	368	240	184	317	249	264	298	353	389	351	347	395	307	239	226	261	321	130
欧州	172	39	76	70	68	77	50	77	98	144	72	170	150	190	108	127	89	94	79	291	112
韓国	219	179	511	251	97	73	52	105	170	189	205	295	173	221	408	351	148	93	355	194	357
台湾	138	66	335	210	200	167	313	410	144	373	346	418	370	305	345	413	483	378	346	351	858
中国	125	54	129	37	44	54	64	102	62	269	249	48	47	45	142	142	257	104	269	282	211
東南ア・他				37	36	28	36	24	60	36	22	22	75	64	32	45	56	37	75	185	116
合計	1,216	752	1,500	1,093	788	750	949	1,156	977	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224	1,593	1,878	1,974
(訂正後)																					
国内	250	163	149	117	100	163	115	187	175	201	184	198	204	249	240	408	290	290	204	251	187
米国	308	247	297	367	240	183	316	250	264	299	351	387	345	328	366	303	207	229	248	329	131
欧州	172	39	76	70	68	77	50	77	98	144	72	170	150	190	108	127	89	94	79	291	112
韓国	219	179	511	251	97	73	52	105	170	189	205	295	173	221	408	351	148	93	355	194	357
台湾	138	66	335	210	200	167	313	410	144	373	346	418	370	305	345	413	483	378	346	351	858
中国	125	54	129	37	44	54	64	102	62	269	249	48	47	45	142	142	257	104	269	282	211
東南ア・他				37	36	28	36	24	60	36	22	22	75	64	32	45	56	37	75	185	116
合計	1,213	751	1,501	1,092	788	749	948	1,157	977	1,514	1,433	1,542	1,366	1,405	1,643	1,792	1,534	1,228	1,579	1,886	1,974
(訂正差額)																					
国内																					
米国	-2	-1	0	-0	-0	-0	-1	1	0	1	-1	-1	-6	-19	-29	-4	-31	3	-13	8	0
欧州																					
韓国																					
台湾																					
中国																					
東南ア・他																					
合計	-2	-1	0	-0	-0	-0	-1	1	0	1	-1	-1	-6	-19	-29	-4	-31	3	-13	8	0

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ